

第6章

最高のパフォーマンスでハイレゾ再生&科学シミュレーション!

冷やし職人
参上



連続1.2 GHz 運転! ヒートシンクと冷却ファンによる放熱実験

橋 純一 Junichi Tachibana

● CPUを冷やしていつも1.2 GHzパフォーマンス

最新型のラズベリー・パイ3が発売され、機能が大幅にアップして飛ぶように売られているようです。ラズベリー・パイ2までは、マニアだけが使っていた印象がありますが、高速CPU(1.2GHz、64ビット、14×14mmのBGAパッケージ、型名BCM2837)とWi-Fi無線が搭載されて、スマホのように簡単に使えるようになったためのようです。

ここでひとつ課題なのが熱の問題です。

ラズベリー・パイ3に搭載されているCPU(BCM2837)は、温度が上昇するとクロック周波数と動作電源電圧を落として、CPUを破壊から守る安全回路が仕組みられています。通常の使い方をしてる限り、大きな問題にならないようですが、

- 複数アプリケーションを動かしたい
- 直射日光が当たる場所で使いたい
- 科学計算やシミュレーションをさせたい

など、よくある条件下で、**せっきゃく1.2 GHzの処理性能をもっているのに、初代ラズベリー・パイ(2012年、動作クロック700 MHz、ARM11)より低い600 MHzで動かすことになります。**これでは宝の持ち腐れです。

*

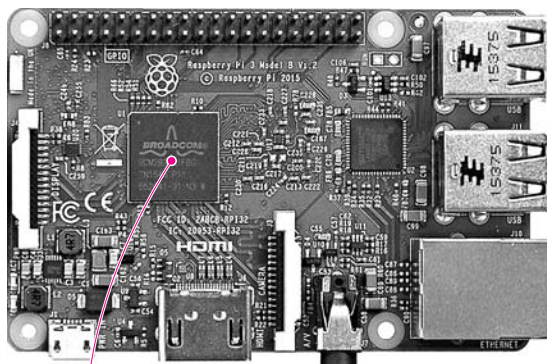
本稿ではこの点に焦点を当てて、普段、産業用機器の熱問題に対峙している立場から解説します。今回はCPUだけに負荷を与えるテスト・プログラムを走らせて実験します。

手がかりなし… ラズベリー・パイ3の放熱対策

● ラズベリー・パイに搭載されているCPUのメーカーは熱的仕様を公開していない

通常、半導体メーカーは、電気的仕様やパッケージ形状、熱的仕様をホームページなどで無料で公開しています。

ところが、ラズベリー・パイ3に搭載されているCPU(BCM2837)のデータシートは、メーカーである



● CPUの周りに背の高い部品がないことから、開発者はヒートシンクを取り付けることを想定しているように見える

写真1 放熱して使うことが前提なのか?ラズベリー・パイ3のCPU周りには背の高い部品がない

Broadcom(現在はAvago Technologies)のホームページで型名を検索しても見つかりません。過去のラズベリー・パイに搭載されているCPU(BCM2836やBCM2835)も同様です。

ラズベリー・パイの開発元(ラズベリー・パイ財団 <https://www.raspberrypi.org/>)のホームページを調べると、BCM2836とBCM2835の英文資料が見つかりますが、温度仕様に関する情報は得られませんでした。

● 放熱前提で設計されている?

ラズベリー・パイ3(写真1)の外観を眺めると、CPU周辺に背の高い部品がなく、ヒートシンクを取り付けるスペースを確保できそうです。「**放熱対策が必要です**」と言っているようにも見えます。

● 誰が使っても壊れないように安全装置が組み込まれている

ラズベリー・パイは、CPUが一定温度以上にならないように、CPUのクロック周波数や動作電源電圧を調節したり、プログラムをシャットダウンする安全装置を組み込んでいます。つまり「壊れないように作